



## 日月光半導體製造股份有限公司宣佈 2005 年九月營業收入淨額

日月光半導體製造股份有限公司 (TAIEX: 2311, NYSE: ASX) 於今日宣佈其 2005 年 9 月及第三季之內部自行結算集團合併營業收入淨額。日月光公司並於今日同時宣佈，該公司之子公司新加坡福雷電子已與 Flextronics 簽訂資產買賣契約，由 Flextronics 收購福雷電子位於馬來西亞檳城廠的 CMOS 模組部門。福雷電子將出售該部門之生產機具設備與存貨，同時移轉該部門之員工約 1 千 300 人予 Flextronics。本資產買賣交易金額約為 1,870 萬美元，包括將被移轉之生產機具設備與存貨之帳面價值以及其他無形資產。雙方除了簽訂資產買賣合約之外，亦簽訂租約，由 Flextronics 承租模組部門目前營運所使用之廠房，雙方亦將簽訂移轉服務契約，以確保該部門順利之移轉。

依合約規定，自 2005 年 9 月 1 日起至 2005 年 9 月 30 日為移轉過渡期，該期間福雷電子僅就該模組部門產生之製造成本不加計利潤向 Flextronics 收費，故自 2005 年 9 月 1 日起，福雷電子及日月光不再認列該模組部門所產生之營收。

### 集團合併營業收入淨額 (內部自行結算) \*

(新台幣 佰萬元)	九月 2005	八月 2005	九月 2004	與上期比較	與去年同期比較
不包含馬來西亞 CMOS 模組部門之 營業收入淨額	7,951	7,338	6,832	8%	16%
馬來西亞 CMOS 模組部門之營業 收入淨額	0	274	581		
總營業收入淨額	7,951	7,612	7,413	4%	7%

(新台幣 佰萬元)	第三季 2005	第二季 2005	第三季 2004	與上期比較	與去年同期比較
不包含馬來西亞 CMOS 模組部門之 營業收入淨額	21,822	17,988	20,272	21%	8%
馬來西亞 CMOS 模組部門之營業 收入淨額	518	831	1,750		
總營業收入淨額	22,340	18,819	22,022	19%	1%

\*集團合併營業收入淨額包括日月光半導體製造股份有限公司高雄封裝廠、中壢封裝測試廠 (原日月欣半導體)、新加坡福雷電子、日月光韓國廠以及日月光日本廠。

新聞聯絡人：

日月光集團

劉詩亮 財務部副總經理

# Advanced Semiconductor Engineering, Inc.



電話：02-8780-5489

傳真：02-2757-6121

ir@aseglobal.com

<http://www.aseglobal.com>